

PROZESSE DIE ZU IHNEN PASSEN

Technologien und Techniken sind häufig austauschbar und eignen sich nur bedingt zur Differenzierung in breiten Märkten. Daher konzentrieren wir uns – neben den eigentlichen Technologien – auf effiziente Prozesse und optimierte Herstellkosten.

Das reicht von Machbarkeitsstudien über einen eigenen Musterbau für die Entwicklungsphase bis zu einer stetigen Prozessevaluierung und -optimierung. Wir erarbeiten und definieren zudem Designrichtlinien und halten auf Wunsch ein ausführliches

Berichtswesen für unsere Kunden vor. Auch im Serienbetrieb und dem Supply Chain Management arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um möglichst effiziente Prozesse zu generieren.

Leuze electronic assembly GmbH
Stützenstraße 3
89619 Unterstadion
Telefon +49 7393 9508-0
Telefax +49 7393 9508-29
www.leuze-electronic-assembly.de
assembly@leuze.com

 **Leuze electronic**

the **sensor** people

**ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND
VERTRIEB VON ELEKTRONISCHEN BAUGRUPPEN**
DIE LEUZE ELECTRONIC ASSEMBLY GMBH

ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR ELEKTRONISCHE FLACHBAUGRUPPEN (PCBA)

Seit 1977 steht die Leuze electronic assembly GmbH für höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen Baugruppen auf starren und flexiblen Leiterplatten. Mit über 200 Mitarbeitern realisieren wir auf unserem modernen Maschinenpark variable Losgrößen von

1 bis 10.000. Flexibel erfüllen wir in der Produktion und Logistik Ihre Anforderungen. Als Teil der international erfolgreich agierenden Leuze Gruppe sind wir weltweit vertreten und profitieren von einem professionellen Qualitäts- und Lieferantenmanagement.



Produziert wird gruppenintern für die Leuze electronic GmbH und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit für Kunden mit den Schwerpunkten Medizin- und Industrieelektronik. Wir werden höchsten Qualitäts- und Technologieansprüchen gerecht.

FACHKOMPETENZ MIT HOHEN STANDARDS

Sie können auf unseren großen Erfahrungsschatz in der THT- und SMT-Technologie auf flexiblen oder starren Schaltungsträgern zurückgreifen – egal ob einfache Leiterplatten oder komplexe mehrlagige HDI Strukturen. Unsere Spezialität sind Verbindungstechnologien auf flexiblem Trägermaterial, sowie die Bestückung von fine pitch BGAs.

Die Leiterplattenbestückung ist RoHS konform / bleifrei und arbeitet mit modernsten Prüftechnologien wie SPI, 3D AOI und ICT (Flying Probe oder Nadelbett). Auf Wunsch fertigen wir gemäß IPC-J-STD-001 class 3.



Unsere Fachkompetenzen:

- FPC (Flexible Printed Circuits)
- Komplexe Lötaufgaben (bleifrei / verbleit)
- Exaktmontage im μm Bereich
- BGA (Ball Grid Array)
- Box Build Assembly

SPEZIFISCHE LÖSUNGEN WIRTSCHAFTLICH REALISIERT

Mit unserem jahrzehntelangen Know-how in der Aufbau- und Verbindungstechnik beraten und betreuen wir alle unsere Kunden sehr individuell. Dabei punkten unsere Lösungen durch ihren hohen Innovationsgrad und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit mehreren Bestückungslinien für spezifische Kundenanforderungen (3.000 bis 80.000 Komponenten/h) erzielen wir wirtschaftliche Ergebnisse.

UL- und CSA-zertifizierte Fertigungsstätte:

- Industrial Engineering
- Fertigung
 - Bedrucken
 - Bestücken
 - Löten
 - Nutzentrennen
 - Reinigen
 - Optische Prozesskontrolle (AOI)
 - Box Build Assembly
 - Incircuit Test
 - Funktionstest
 - Einpresstechnik
 - Lackieren
- Supply Chain Management

